

次世代センサ基盤分科会

本分科会のポイント

- 次世代を狙う挑戦的なセンサデバイスの創出を目標に活動を行います
- 機能性材料、製造プロセス、実装、設計等の技術動向の調査と課題の抽出を行います
- 参加メンバーとの連携プロジェクト提案に繋がっていきます

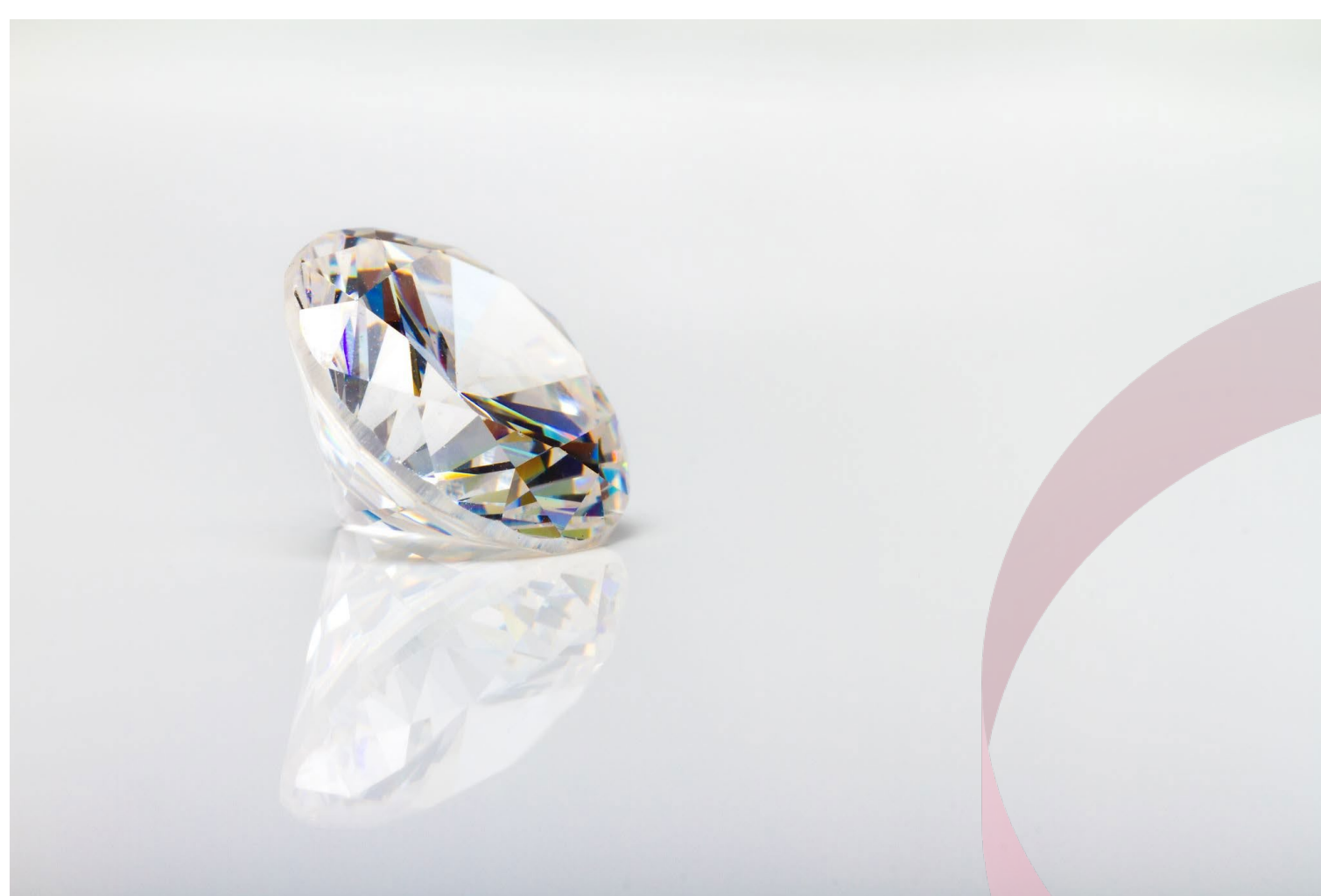
本分科会のねらい

高度情報化社会では、エッジデバイスとクラウド間の大容量・高速通信による情報収集とクラウドやエッジでのAIによる高度な情報分析により、経済活動や日常生活にこれまでにない利便性と価値創造を提供することが期待されています。センサは情報収集の入口であり、その高度化と多様化はますます重要となっています。本分科会では、マルチモーダル、エッジAIデバイス、超高感度、超ダイナミックレンジなどをキーワードとした次世代センサに関して、センシングを実現させる機能性材料やセンサ設計・製造プロセス、その実装方法など最新の技術動向を調査し、技術課題の抽出を行います。これらの情報をもとに参加メンバーと開発戦略の策定を行い、技術開発のパートナーとしての協力関係を構築していくことを目指しています。将来的には新たなプロジェクト提案に向けて共同で取り組んでいきます。

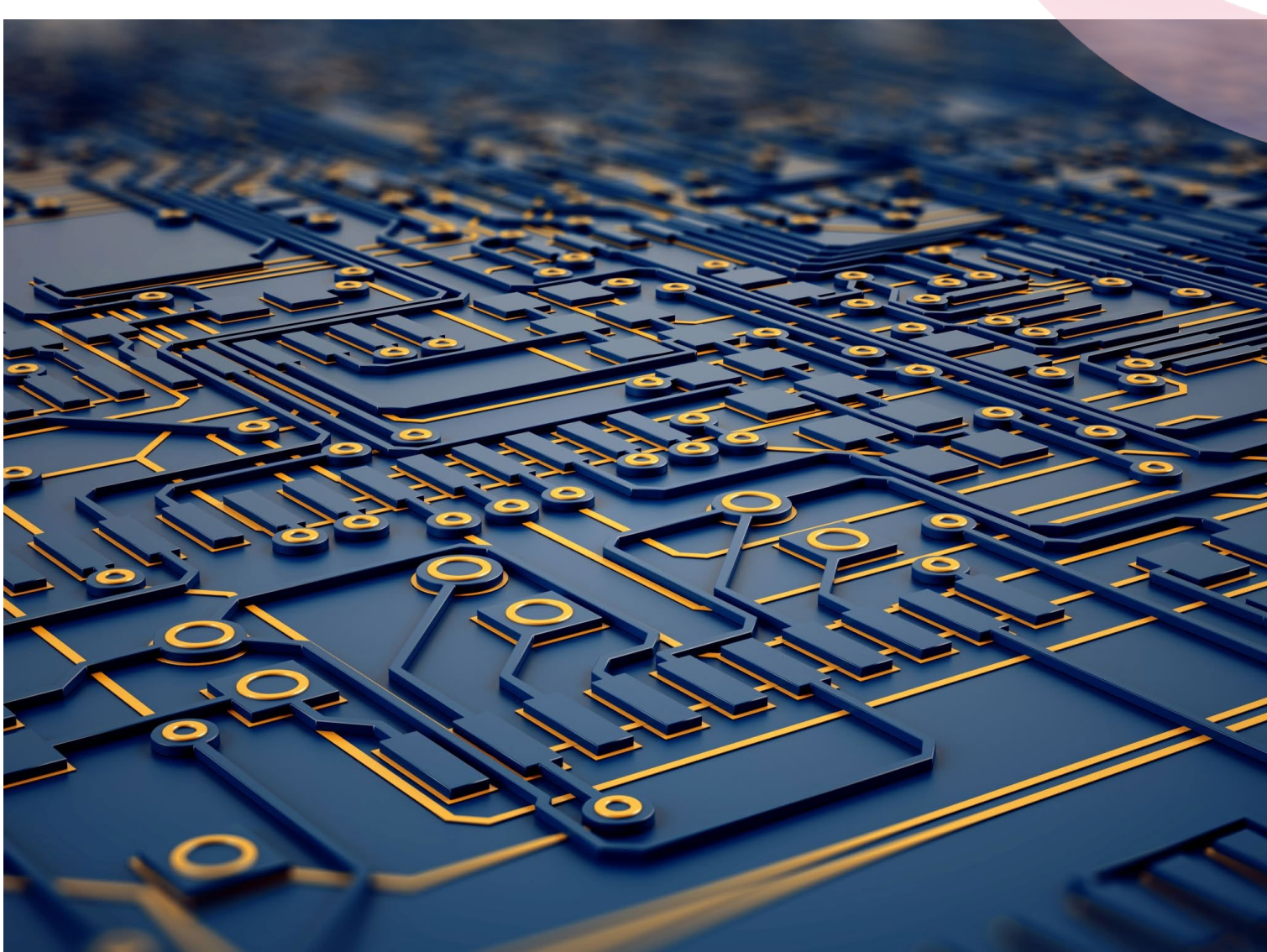
活 動 内 容

本分科会では、量子技術やMEMS技術等の次世代センサに関係する機能性材料、デバイス設計・製造プロセス技術、センサフュージョンやマルチモーダル化等の新しいセンシング概念の最新動向について専門家による講演や産総研の技術紹介を行い、情報共有と議論を目的とした分科会を年3回程度開催します。参画メンバーと技術開発要素の策定と共同研究の実施や公的資金への共同提案を目指します。

機能性材料



デバイス実装



デバイス設計・製造プロセス



- 講演会
- 技術課題抽出
- プロジェクト提案



センシングシステム研究センター

山田 浩志 (hiro-yamada@aist.go.jp)
上原 雅人 (m.uehara@aist.go.jp)

国立研究開発法人
産業技術総合研究所